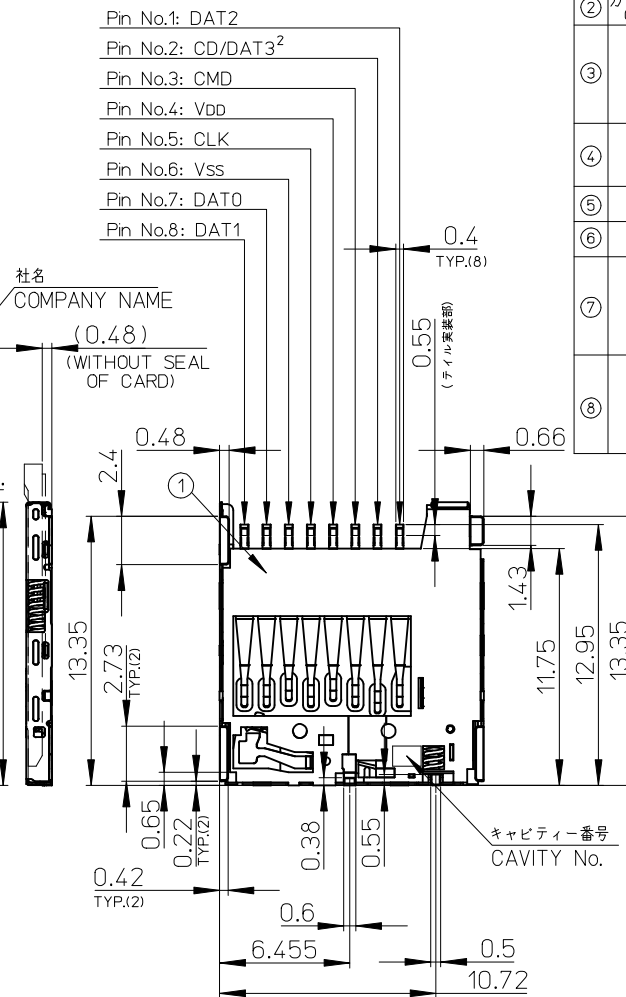
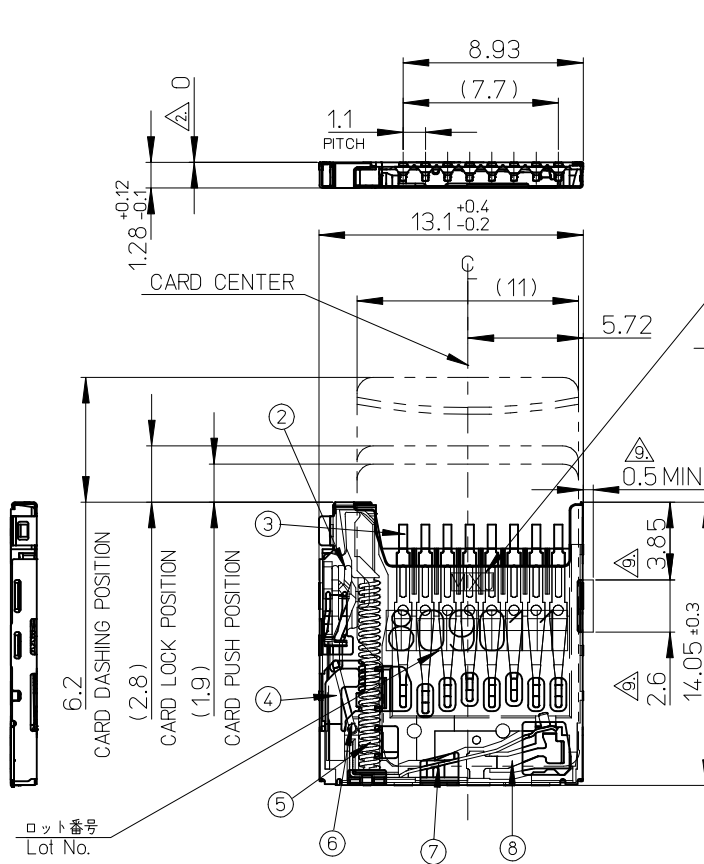


CONFIDENTIAL



番号 NO.	名称 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ(めっき) FINISHES (PLATING)
①	ハウジング HOUSING	液晶ポリマー(LCP)、ガラス充填、UL94 V-0、黒 LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94 V-0, BLACK	
②	カムスライダー CAM SLIDER	液晶ポリマー(LCP)、ガラス充填、UL94 V-0、黒 LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94 V-0, BLACK	
③	ターミナル TERMINAL	焼青銅 PHOSPHOR BRONZE	接触部: 金めっき (0.5 μm MIN.) テール部: 錫めっき (2.0 μm MIN.) 下地: ニッケルめっき (1.0 μm MIN.) CONTACT AREA: GOLD PLATING (0.5 MICROMETER MINIMUM.) SOLDER TAIL AREA: TIN PLATING (2.0 MICROMETER MINIMUM.) UNDERPLATE: NICKEL OVERALL (1.0 MICROMETER MINIMUM.)
④	シェル SHELL	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	下地: ニッケルめっき NAIL AREA: GOLD PLATING UNDERPLATE: NICKEL OVERALL
⑤	スプリング SPRING	ピアノ線 SWP	全面: ニッケルめっき NICKEL OVERALL
⑥	ピン PIN	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	
⑦	ディテクト レバー DETECT LEVER	焼青銅 PHOSPHOR BRONZE	接触部: 金めっき (0.2 μm MIN.) 基板実装部: 金めっき 下地: ニッケルめっき CONTACT AREA: GOLD PLATING (0.2 MICROMETER MINIMUM.) NAIL AREA: GOLD PLATING UNDERPLATE: NICKEL OVERALL
⑧	ディテクト スイッチ DETECT SWITCH	焼青銅 PHOSPHOR BRONZE	接触部: 金めっき (0.2 μm MIN.) 基板実装部: 金めっき 下地: ニッケルめっき CONTACT AREA: GOLD PLATING (0.2 MICROMETER MINIMUM.) NAIL AREA: GOLD PLATING UNDERPLATE: NICKEL OVERALL

NOTES

- ターミナル及びネイルの平坦度は 0.1 MAX.
(測定用定板面を基準)
TERMINAL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.(FROM GAUGE PLANE)
- ② スタンドオフ寸法 STAND OFF
- ③ パターン禁止エリア PATTERN PROHIBITION AREA
- カード検知スイッチ DETECT SWITCH

カード挿入時 CARD INSERTING POSITION	クローズ CLOSE
カード未挿入時 NO CARD	オープン OPEN

- 肉抜き位置は任意とする。CAVITY IS TO BE OPTIONAL.
- ロット印字は任意とする。LOT NUMBERING IS TO BE OPTIONAL.
- ④ GND 推奨パターン GND RECOMMENDED PATTERN.
- ELV 及び RoHS 適合品 ELV AND RoHS COMPLIANT.
- ⑤ カード裏挿し誤挿入時、カード突出エリア
(他の部品の設置、非推奨範囲)
WHEN A CARD IS MISS-MATED IN THE REVERSE ORIENTATION,
PART OF THE CARD PROTRUDES FROM THE SHELL DUE TO
THE CARD-MISS MATING PREVENTION FEATURE.
THEREFORE, NO COMPONENTS ARE ALLOWED TO BE PLACED IN THIS AREA.

503398-0891	8
EMBOSSED PACKAGE	極数
オーダー番号 ORDER NO.	CIRCUITS
CONNECTOR SERIES No. 503398-0811	

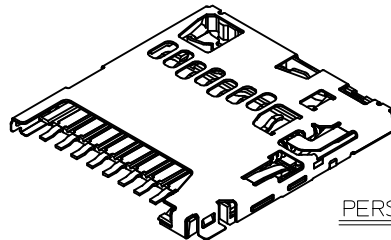
SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
--------------	------------------------	---------------------------

MICRO SD CONN.
PUSH/PUSH & NORMAL
SUPER-SMALL TYPE

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-503398-001 SHEET NO. 1 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

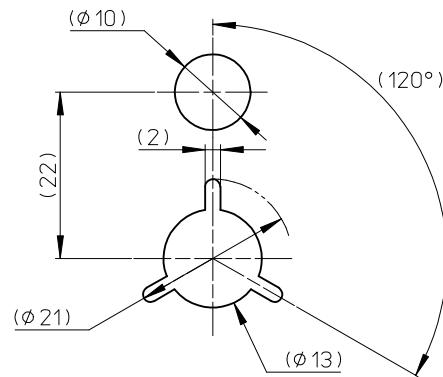
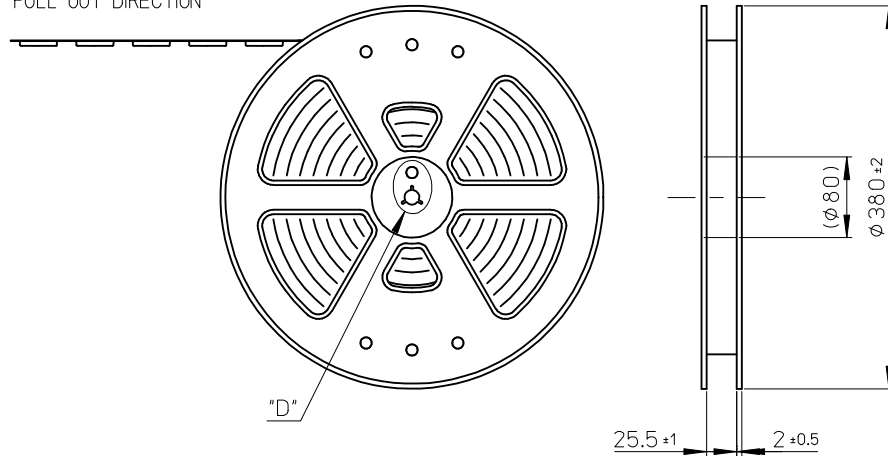


PERSPECTIVE VIEW

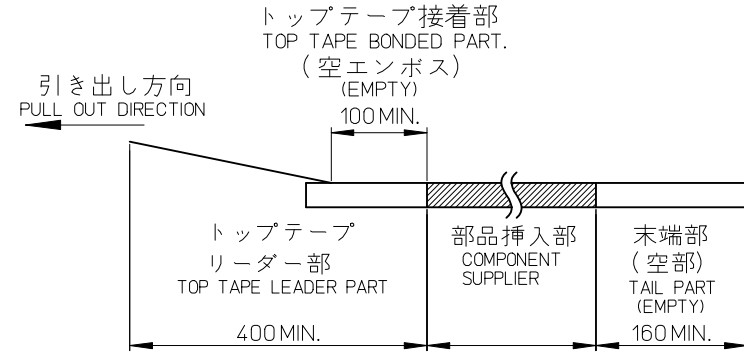
NOTES

- 製品詳細寸法については、SD 図面を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SALES DRAWING.
- 梱包数量：2400個／リール
NUMBER OF CONNECTORS：2400 PCS/REEL.
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH.

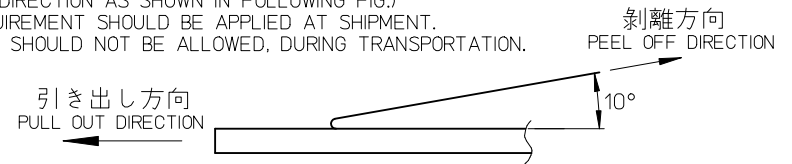
引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



DETAIL "D"



- トップテープの剥離強度：JIS C0806-3に準拠(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : BASED UPON JIS C0806-3
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料 MATERIAL
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリスチレン (POLYSTYRENE)
トップテープ (TOP TAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

503398-0891	8
EMBOSSED PACKAGE	極数
オーダー番号 ORDER NO.	CIRCUITS
CONNECTOR SERIES No. 503398-0811	

PROPOSED EC NO: J2010-0539 DRWN:YMATSUMOTO CHKD:YMATSUMOTO APPR:NAKATSUMOTO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY YMATSUMOTO	DATE 2009/02/02	TITLE EMBOSSED TAPE PACKAGE FOR 503398-08**				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY MTOMITA	DATE 2009/02/02					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY NUKITA	DATE 2009/02/02					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503398-002		1 OF 2		
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

